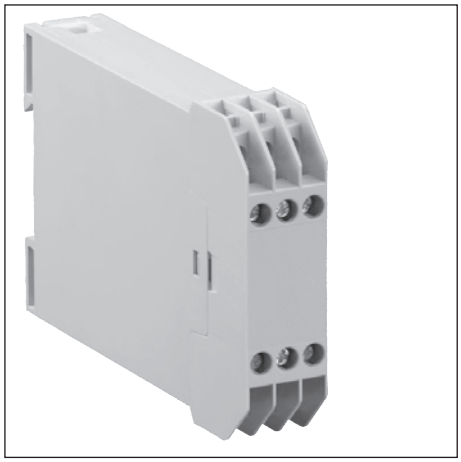
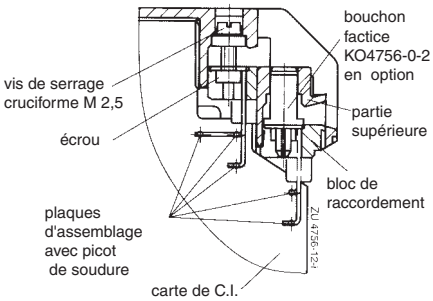
Boîtiers en matière isolante KO 4757

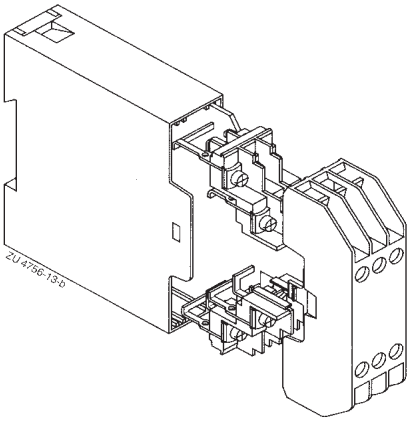
avec bornes plates
pour technique de soudure mécanique



- Largeur 22,5 mm
- Max. 12 vis de serrage cruciformes avec brides solidaires.
- Connexion sécurisée de 2 câbles max. même de section différente
- Connexions pour soudure mécanique, possibilité de raccordement par multibrins
- Large surface pour éléments de commande et d'affichage et pour l'inscription
- Boîtier livré prêt à assembler, avec bornes pré-montées dans leurs blocs



Bornes plates pour soudure mécanique



KO 4757

Caractéristiques techniques

Référence de commande:	KO 4757.0046336
Dimensions extérieures:	22,5 x 82 x 118,2 mm
Matériau des boîtiers:	PC-GF gris clair RAL 7035

Résistance à la température		PC
selon UL 746 B:		125 °C
selon Vicat ISO 306	méth. B:	148 °C
selon ISO 75-2	méth. A:	138 °C
	méth. B:	144 °C

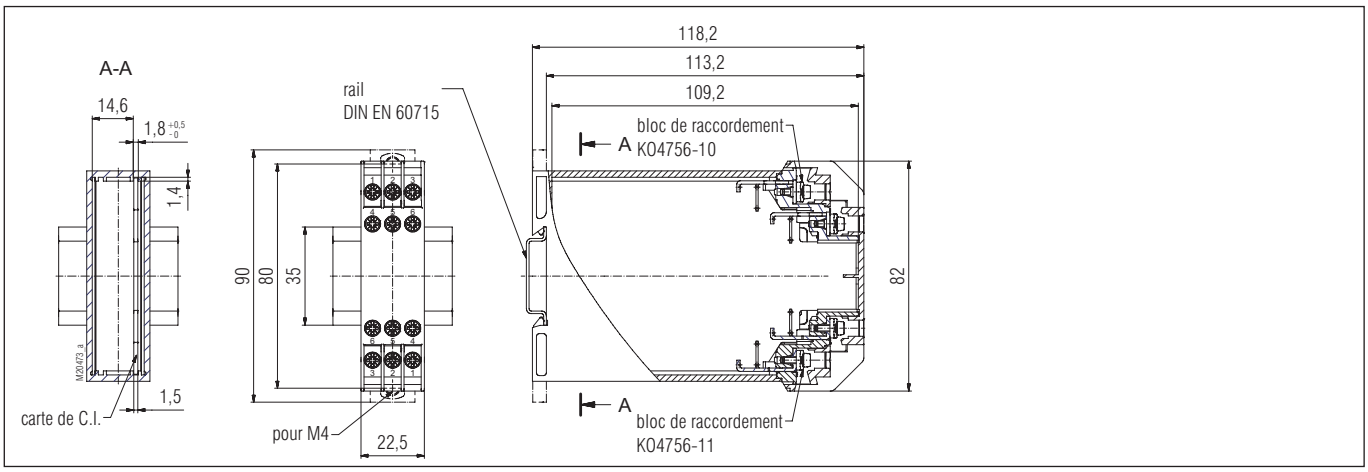
Puiss. dissipée max. admissible: en climat normal 23 / 50-1 — ISO 554

distance entre boîtiers	puissance dissipée P_V
0 mm	4 W
16 mm	7,5 W
∞	10 W

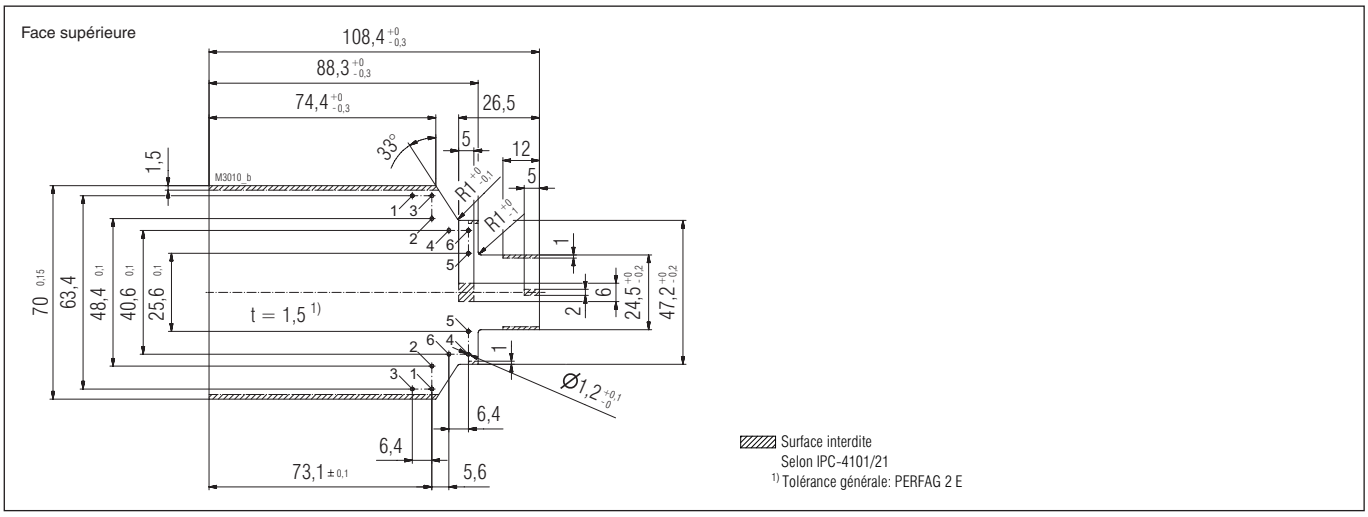
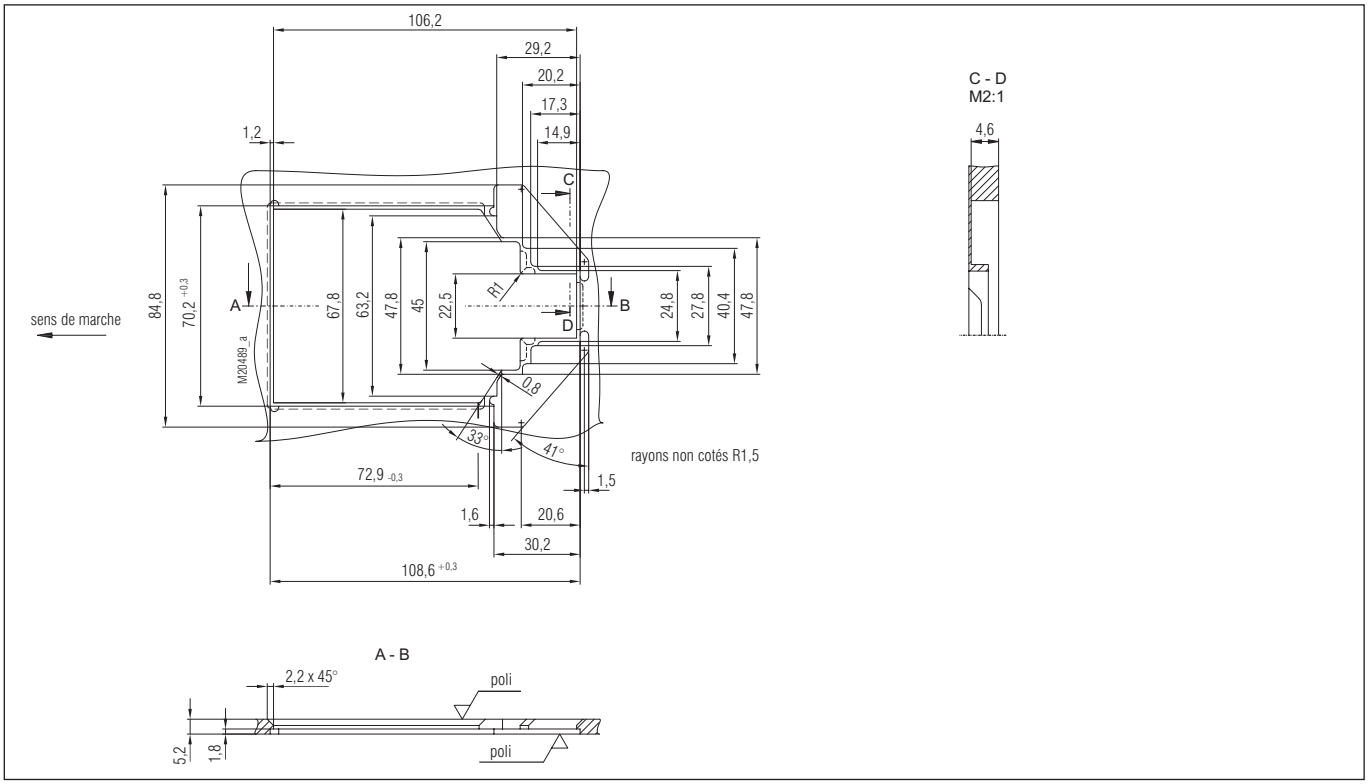
Résistance thermique spécifique:	R_{th} = 10 K / W pour boîtier isolé
Inflammabilité selon UL 94:	V-0
selon IEC 60707:	BH 2-30
Nombre de bornes:	max. 12, numérotation interne de 1 à 6
Matériau des bornes:	feuillard d'acier étamé
Sections max. des conducteurs:	max. 2 x 2,5 mm² massif ou max. 2 x 1,5 mm² multibrins avec embout — DIN 46228-1/-2/-3 max. 2 x 1 mm² multibrins avec embout — DIN 46228-4
Longueur à dénuder:	8 mm
Résistance de contact max. vers la carte de C.I.:	20 mΩ
Charge admissible max.:	20 A
Connectique:	vis cruciformes imperdables M2,5 avec brides solidaires . Fonctionnement selon IEC 60999-1
Couple de réglage:	0,4 Nm max.
Connexions internes:	picots pour soudure mécanique sur la carte de C.I. et point de soudure pour multibrins ø1,8 mm max.
Fixation des boîtiers:	1. par encliquetage sur rail — EN 60715 2. par vis à l'aide de pattes extractables, entr'axe de fixation 80 mm pour 2 vis M 4
Tenue aux courants de fuite: PC:	CTI 175 ≙ classe d'isolement III a — IEC 60664-1
Distances dans l'air et lignes de fuite:	distances dans l'air ≥ 3,2 mm — IEC 60664-1 lignes de fuite ≥ 5,0 mm — IEC 60664-1
Degré de protection	IEC 60529
boîtier:	IP 40
bornes:	IP 20
bornes non garnies:	IP 20
borne non garnie avec option bouchon factice:	IP 40 protection contre les contacts directs selon VBG 4
Surface de marquage:	30 x 21,5 mm
Cartes de C.I.:	voir découpe
Fixation des cartes de C.I.:	par nervures
Accessoires:	bouchon factice KO 4756-0-2

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l'édition en cours. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.

Dimensions



Découpes des cartes de C.I.



Masque pour châssis de soudure